电子封装、环氧树脂塑封料用方石英微粉

产品名称	电子封装、环氧树脂塑封料用方石英微粉
公司名称	广州市汇宇贸易发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	原产地:中国 二氧化硅含量:99.5（%） 熔点:1713（℃）
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广花公路（夏茅段）广州世盛工业品展览中心A7座7-8号
联系电话	13902732462

产品详情

原产地	中国	二氧化硅含量	99.5（%）
熔点	1713（℃）	莫氏硬度	6.5
密度	2.33（g/cm3）		

电子封装、环氧树脂塑封料用方石英微粉采用国内先进的专有的无污染生产技术和优质高纯的石英矿经高温煅烧研磨分级制备而成，产品具有以下优良性能:（1）纯度高、离子含量低、电导率低；（2）天然呈准球形，粒度分布合理，以此为填料生产的环氧塑封料具有更佳的流动性能，并能有效地减少溢料；（3）跟环氧树脂混合透明度好，耐热和抗紫外线，增加led出光效率，降低led的热阻，提供高可靠度和使用寿命；（4）抗热震性优良，方石英受热220-240°C左右时，发生一定程度的热膨胀，正好补偿环氧树脂、石膏等在此温度下固化反应时的收缩，使浇注体不变形。有效地防止固化物开裂，更能全面改善其性能、提高强度、韧性、延伸率、耐磨性、光洁度、抗老化等，这一特性特别适合于环氧浇注料、覆铜板、灌封胶及精密铸造的应用。

产品技术参数

成分	sio2	al2o3	fe2o3	tio2	na2o	k2o	cao	烧失量
含量（%）	99.5	0.18	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.05

粒度分布及物理性能

产品名称 产品规格	粒径	wt-600	wt-700	wt-800
激光粒度分析	23μm/%	100	100	100
	15μm/%	99.9	100	100
	10μm/%	90	100	100

	5μm/%	55	90	99.9
	2μm/%	15	40	70
	d50/μm	4.5	2.5	1.5
比表面积(m2/g)		0.95	1.63	2.0
吸油量(g/100g)		38	40	50
白度（%）		94	94	95
ph值		7±0.2	7±0.2	7±0.2
电导率ec(μs/cm)		10	10	10
密度（g/cm3）	2.33			
莫氏硬度	6.5			
水分（%）		0.05	0.05	0.05